(19)日本国特許庁 (JP)

H 0 1 L 21/3206

(12)特 許 公 報(B2)

(11)特許出頭公也番母

特公平6-69040

(24) (44)公告日 平成6年(1994)8月31日

(51)Int.Cl.*

. 🗟 .

峨洲肥骨

疗内整型骨骨

ΡI

技術数示面所

7514-4M

HOIL 21/88

S

発明の数1(全 4 頁)

			· (22.
(21)出期带号	特顧吲60−100913	(71)出版人 99099999	
		构式会社规定	
(22)出项日	昭和80年(1985) 5 月19日	神織川県川崎市学区堀川町	72番州
(OE) () HUNL 17		(72)税明省 解析 联二	
(85)公開發母	将第四日—258451	神奈川県川崎市帝区堀川町	72番地 株式会
(43)公開日	昭和81年(1986)11月16日	社束芝姆川町工場内	
		(72) 発明者 田哲 忠央	
		利豪川県川崎市や区堀川町	72 砂地 株式会
		让 東芝堀川町工場内	
		(72)死明者 福田 郁郎	
		神奈川県川崎市率区坬川町	72番地 体式会
		社東芝姆川町工場内	
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外	2 %)
		審查官 岡 和久	
			改終頁に続く

(64) 【殆明の名称】 光半導体製置

【特許請求の範囲】

【発明の詳細な説明】

(発明の技術分野)

本発明は許電誘導や電磁誘導に対する耐性を向上させた 半導体装置に関し 特に この福の半導体装置における 対環境個頻性の向上に係る。

【死明の投資的背景】

ICやフォトカブラ等 半導体整度の応用分野は大きな広がりを見せているが、その使用環境は年々悪化してきている。即ち、空中には無数の電磁波が飛交い。またライン電源には電力回路の開閉等により発生するサージ電圧が常時混在していると考えられる。

そこで、このような電磁波やサージ電圧による半導体数 個の摂動作を防止する手段として 半導体チャプ表面に 絶縁膜を介して爆電性シールド膜を被覆するオンチャプ のシールド構造が従来提率されている。例えば 特開昭 80-4257与公報にはオンチャプシールドにより電阻輻射 に対する「Cの耐性を向上させた例が記載されている。